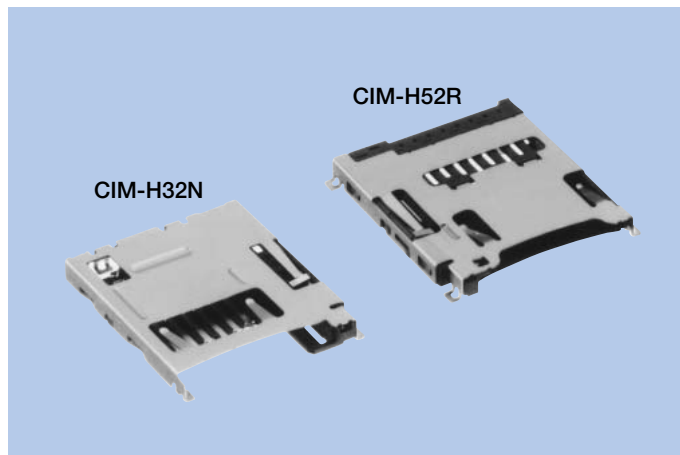


# microSDカード用コネクタ microSD card connectors CIM-H32N, H52R

## 特長／FEATURES

1. Push-in Push-out イジェクト方式  
カード排出量 3.8mm
2. 小型、低背設計です。  
ノーマルマウントタイプ (CIM-H32N) :  
高さ1.85mm 幅13.7mm 奥行き16.0mm  
リバースマウントタイプ (CIM-H52R) :  
高さ1.85mm 幅14.0mm 奥行き16.0mm
3. カード飛び出し防止用のブレーキ機構付き。
4. カード検出スイッチ搭載 (Normally open タイプ)
5. カード排出時のカード脱落防止用ハーフロック付き。



1. Push-in Push-out eject mechanism.  
Card eject distance 3.8mm
2. Small and tin design  
Normal mount type [CIM-H32N] : H 1.85mm  
W 13.7mm Length 16.0mm  
Reverse mount type [CIM-H52R] : H 1.85mm  
W 14.0mm Length 16.0mm
3. Prevent card jump out of a connector with brake mechanism.
4. Switch With card detection [Normally open type]
5. Prevent card drop from connector with half lock mechanism.

## 品名構成／HOW TO ORDER

### 1. CIM-H32N

**H32N-008-21 0 - A G G E**  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① シリーズ名 (H32N: ノーマルタイプ)  
Series No. (H32N : Normal type)
- ② 極数 (008:8極) / No. of contacts (008:8pins)
- ③ ハウジング材質 (21:LCP樹脂)  
Housing material (21:LCP resin)
- ④ ハウジングULグレード (0:UL94V-0)  
Housing UL grade (0:UL94V-0)
- ⑤ コンタクトメッキ種類 (A:金)  
Contact plating (A:Gold)
- ⑥ コンタクトメッキ厚 (G:0.3μm)  
Contact plating thickness (G:0.3μm)
- ⑦ コンタクトリード形状 (G:アングルSMT)  
Contact read style (G:Angle SMT)
- ⑧ 梱包仕様 (E:テーピング) / Package (E:Taping)

### 2. CIM-H52R

**H52R-008-21 0 - A G G E**  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① シリーズ名 (H52R: リバースタイプ)  
Series No. (H52R: Reverse type)
- ② 極数 (008:8極) / No. of contacts (008:8pins)
- ③ ハウジング材質 (21:LCP樹脂)  
Housing material (21:LCP resin)
- ④ ハウジングULグレード (0:UL94V-0)  
Housing UL grade (0:UL94V-0)
- ⑤ コンタクトメッキ種類 (A:金)  
Contact plating (A:Gold)
- ⑥ コンタクトメッキ厚 (G:0.3μm)  
Contact plating thickness (G:0.3μm)
- ⑦ コンタクトリード形状 (G:アングルSMT)  
Contact read style (G:Angle SMT)
- ⑧ 梱包仕様 (E:テーピング) / Package (E:Taping)

## 仕様 / SPECIFICATIONS

### 電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS

|      |                       |   |
|------|-----------------------|---|
| 定格電圧 | Rated Voltage         | AC 50V (rms)                                  |
| 定格電流 | Rated Current         | 0.5A  |
| 耐電圧  | Withstanding Voltage  | 500V AC (rms) 1分間 / 500V AC (rms) 1minute     |
| 絶縁抵抗 | Insulation Resistance | 1000MΩ 以上 (初期値) / 1000MΩ min. (Initial value) |
| 接触抵抗 | Contact Resistance    | 100mΩ 以下 (初期値) / 100mΩ max. (Initial value)   |

### 機械的特性/MECHANICAL CHARACTERISTICS

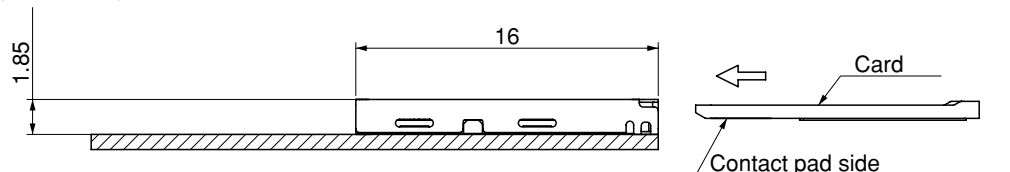
|        |                         |                       |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| 挿抜耐久性  | Life (Matching Cycle)   | 10,000回 / 10,000times |
| カード挿入力 | Card Insertion Force    | 2.0N ~ 6.0N           |
| イジェクト力 | Eject Force             | 2.0N ~ 6.0N           |
| 使用温度範囲 | Using Temperature Range | -25 ~ +85°C           |

## 材質及び表面処理 / MATERIAL & FINISH

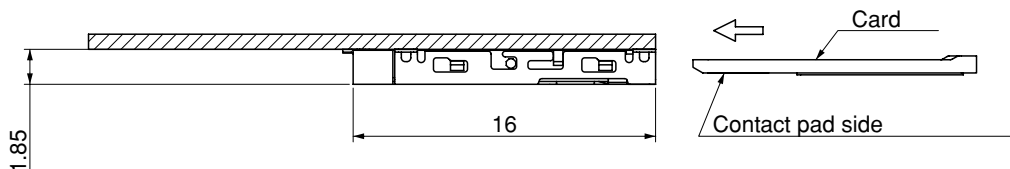
| 部品名/Component Parts      | 材質/Material       | 表面処理/Finish       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ハウジング/Housing            | LCP樹脂/LCP resin   | (黒/Black)         |
| コンタクトピン/Contact          | 銅合金/Copper Alloy  | 金メッキ/Gold plating |
| CDスイッチ Vdd/CD Switch Vdd | 銅合金/Copper Alloy  | 金メッキ/Gold plating |
| CDスイッチ Vss/CD Switch Vss | 銅合金/Copper Alloy  | 金メッキ/Gold plating |
| プレート/Plate               | 銅合金/Copper Alloy  | -                 |
| スライダー/Slider             | PA9T樹脂/PA9T resin | (黒/Black)         |
| ハーフロック/Half Lock         | SUS/SUS           | -                 |
| コイルスプリング/Coil Spring     | SUS/SUS           | -                 |
| ロックピン/Lock Pin           | SUS/SUS           | -                 |

## 基板実装状態 / Board installation condition

Normal type (CIM-H32N)

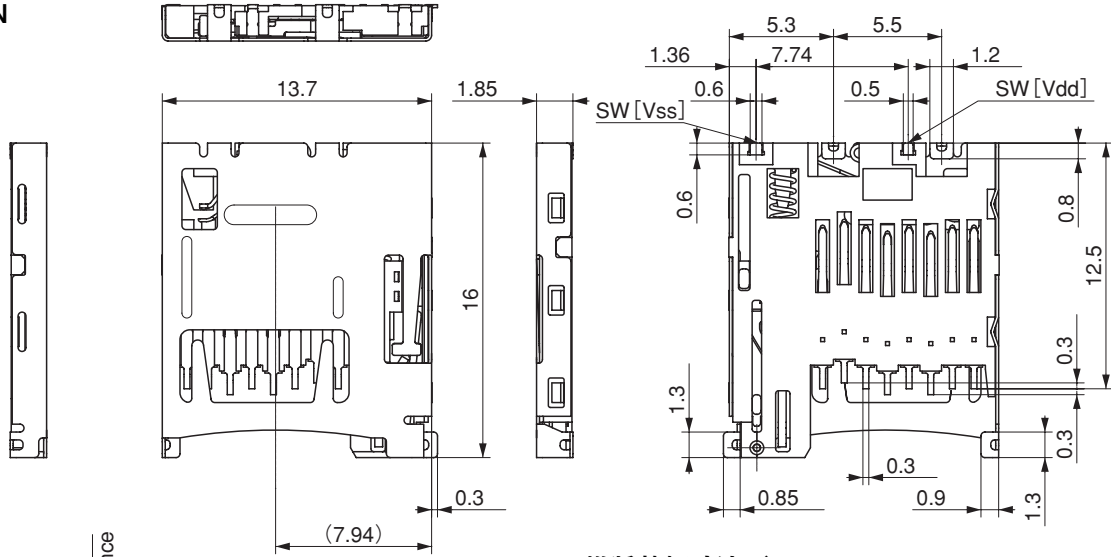


Reverse type (CIM-H52R)

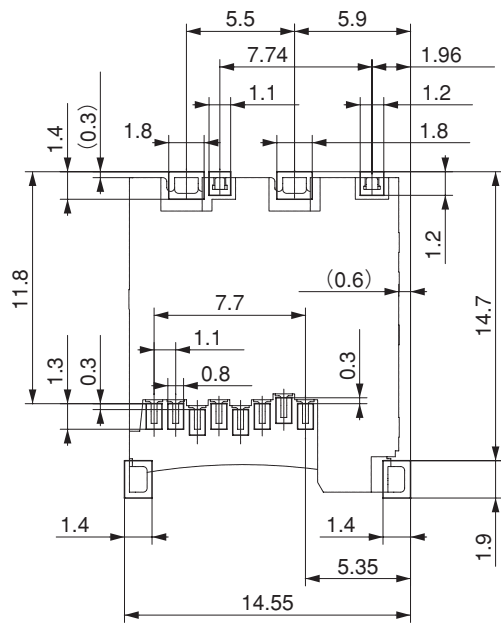


外形図 / DIMENSIONS

CIM-H32N



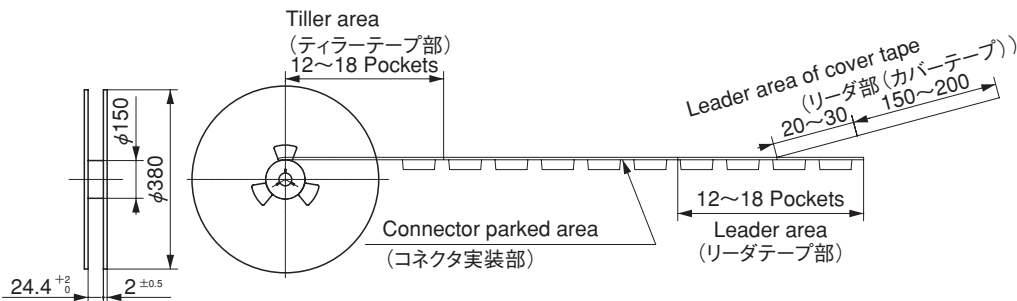
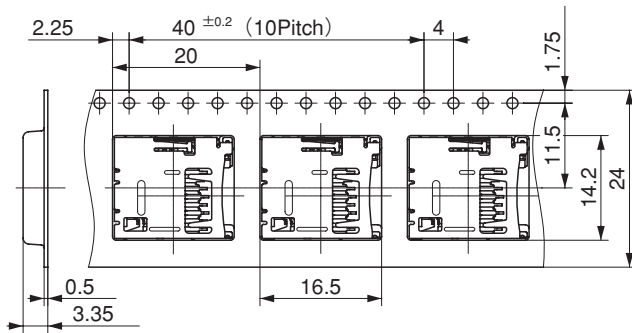
推奨基板寸法 / Recommended PWB layout



Recommended PWB layout (NTS) ±0.05

(推奨基板寸法、±0.05)

梱包仕様 / Packing specification



Unit:mm

